



TSANGYOW

倉佑實業[1568]

2026年第一季營運報告



免責聲明



本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業務成果，可能與這些明示或暗示的預測性資訊有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、匯率波動、市場需求以及其他本公司無法掌控之風險等因素。

本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時再度提醒或更新。

本簡報中的內容，並非投資建議。

目錄

CONTENTS



公司簡介

營運概況

競爭利基

未來發展



//

01

公司簡介

//

CONTINUOUS IMPROVEMENT

EXCEEDING NEEDS

公司簡介

設立日
ESTABLISH



民國74/1/16

資本額
CAPITAL



10.3億

上市時間
Company Listed



民國103年

廠區
Plant



Taiwan 4(嘉義民雄)
Malaysia 1

員工人數
Employees



310

公司簡介-MIT高品質技術



倉佑總公司及中山廠

- 廠區面積：約10,710 m²
- 製程屬性：精密機械加工、齒型加工、研磨、熱處理、組裝



倉佑成功廠

- 廠區面積：約5,200 m²
- 製程屬性：精密機械加工、研磨、雷射銲接



倉佑中山二廠

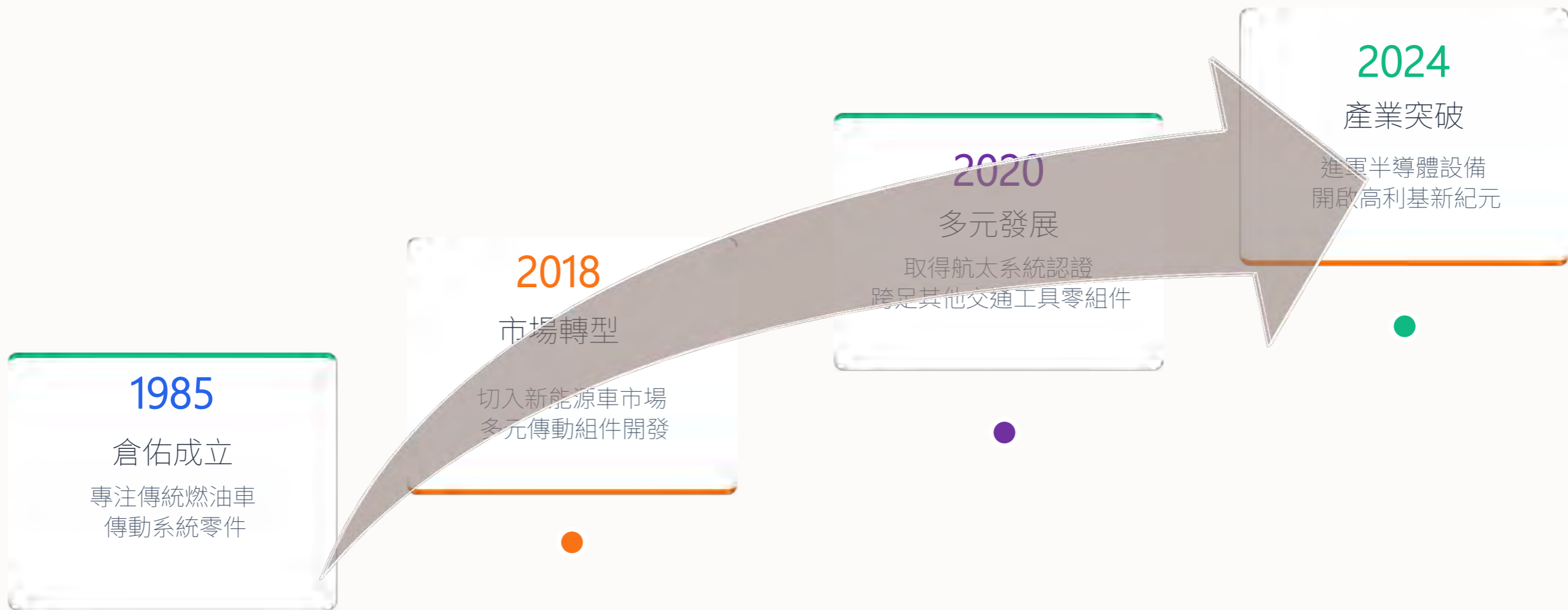
- 廠區面積：約10,600 m²
- 製程屬性：沖壓、精密機械加工、雷射銲接



倉佑中山三廠

- 廠區面積：約8,700 m²
- 製程屬性：沖壓自動化產線、旋壓成型

倉佑啟動營運轉型，以高品質產品跨足多元產業市場



公司簡介-主要產品



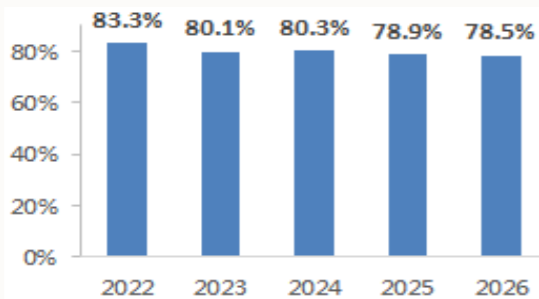
汽車類

倉佑供應之產品

傳動系統零組件：各類變速箱零組件、扭力轉換器、離合器

終端品牌客戶群

Ford、GM、JUGUAR、Range Rover、STELLANTIS、Volkswagen....等



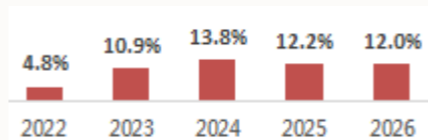
電動車、電動自行車類

倉佑供應之產品

電動車、電動自行車零組件：離合器系統零件、齒輪箱零件、馬達外殼

終端品牌客戶群

Ferrari、VOLVO、Mazda...等



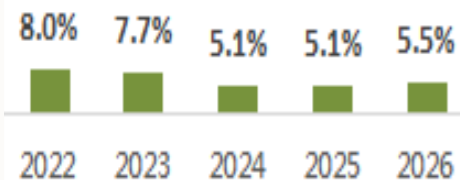
產業機械類

倉佑供應之產品

採礦機、起重機、卡車之離合器、引擎零組件

終端品牌客戶群

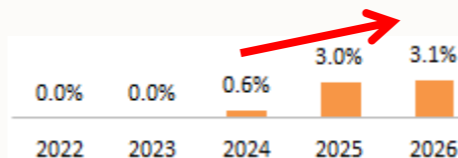
SCANIA、ABB、SUMITOMO、CATERILLAR、JOHN DEERE...等



半導體設備類

倉佑供應之產品

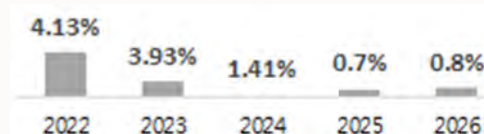
半導體先進製程前段化學機械平坦化（CMP）、物理氣相沉積（PVD）及化學氣相沉積（CVD）等核心製程之關鍵設備零組件等



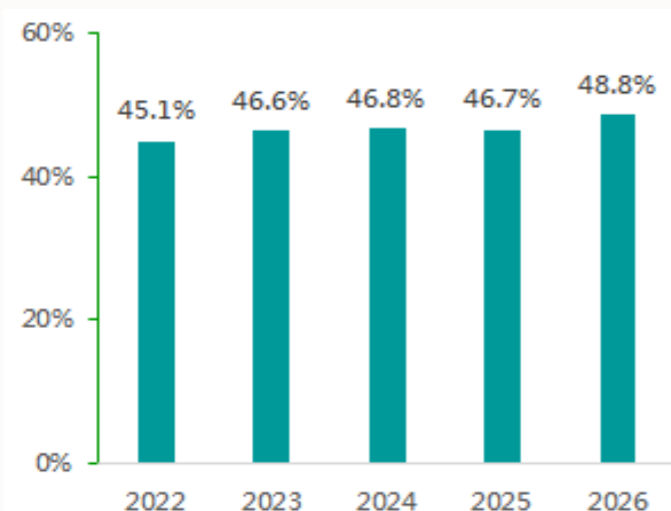
其他類

倉佑供應之產品

船舶類傳動及引擎系統零件、代工件等



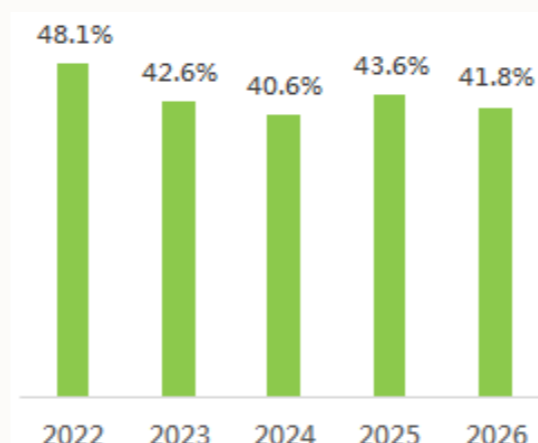
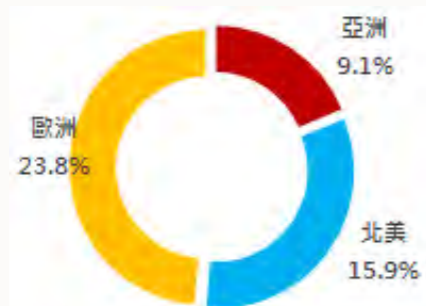
公司簡介-主要市場別客戶



OEM市場

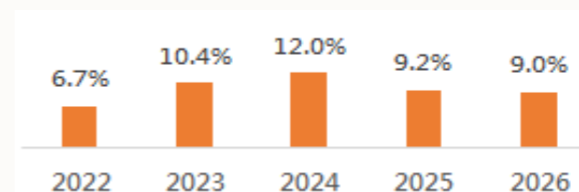
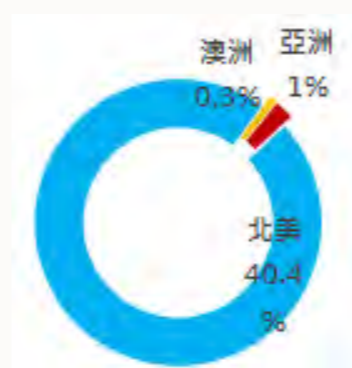
- 汽車傳動系統零組件
- 產業機械傳動系統零組件
- 新能源車零組件
- 半導體設備零件

占整體營收比重
(2026/1Q)



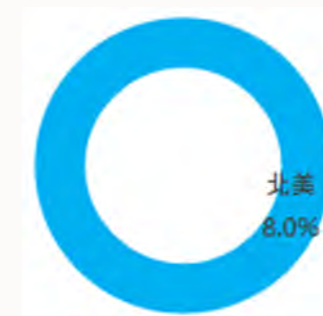
AM市場

- 汽車傳動系統零組件
- 產業機械及卡車離合器
- 引擎、零組件



OES市場

- 汽車傳動系統零組件





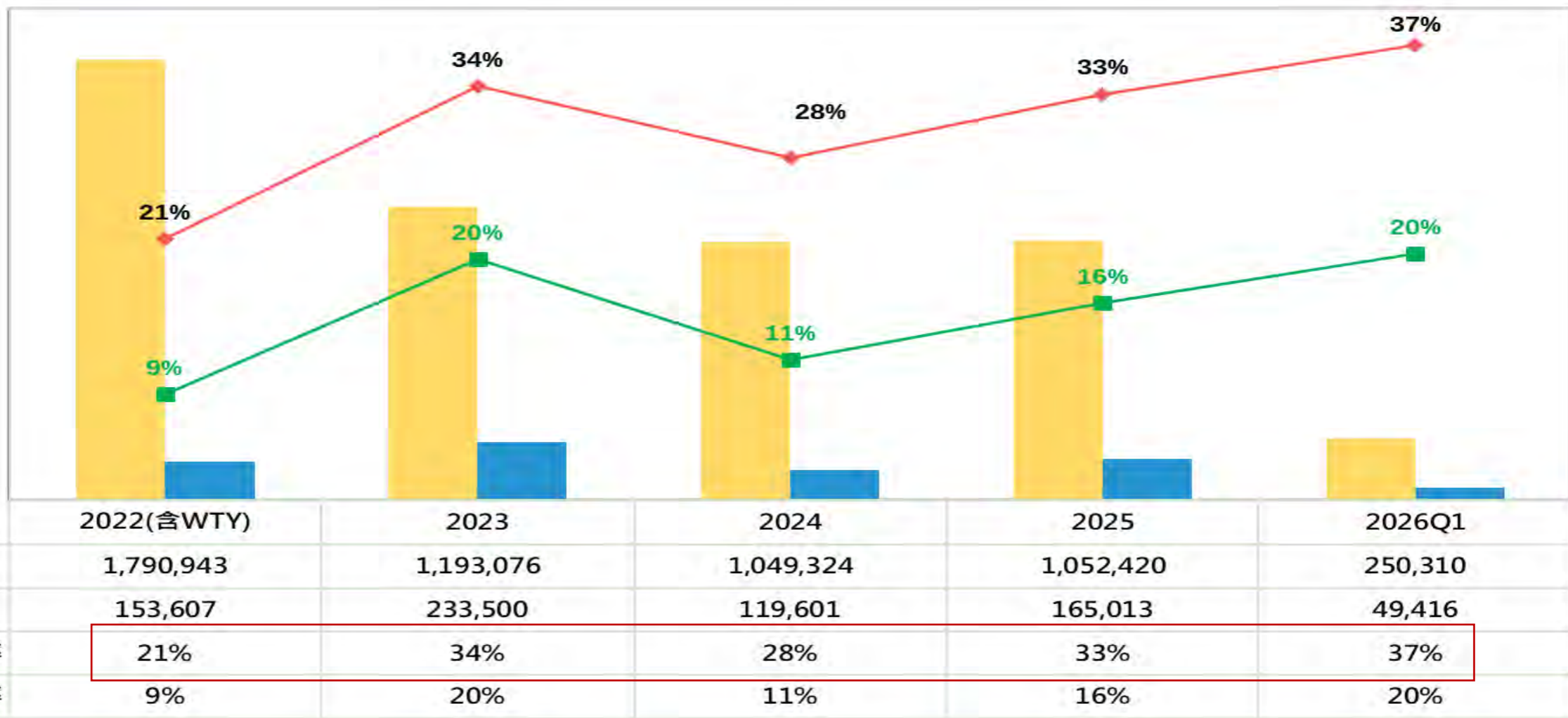
//

02

營運概況

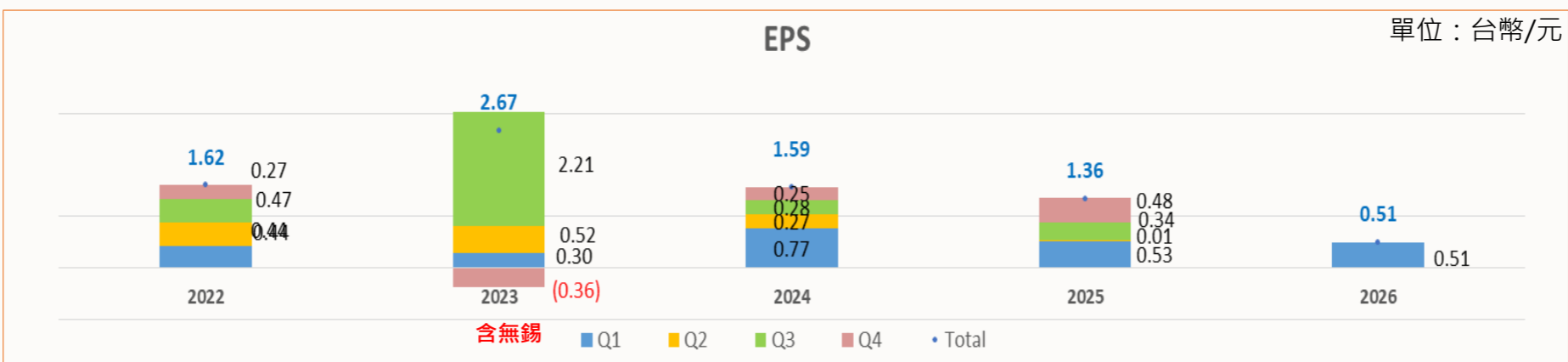
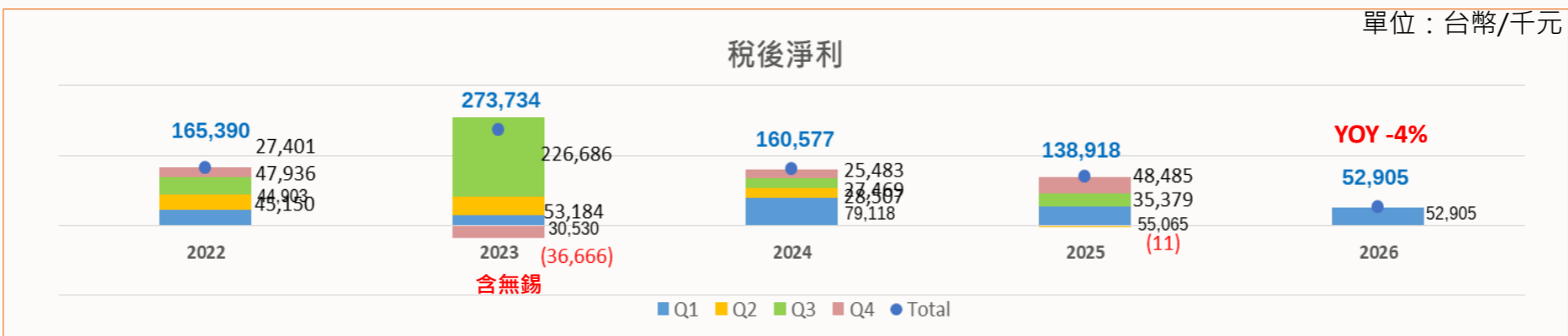
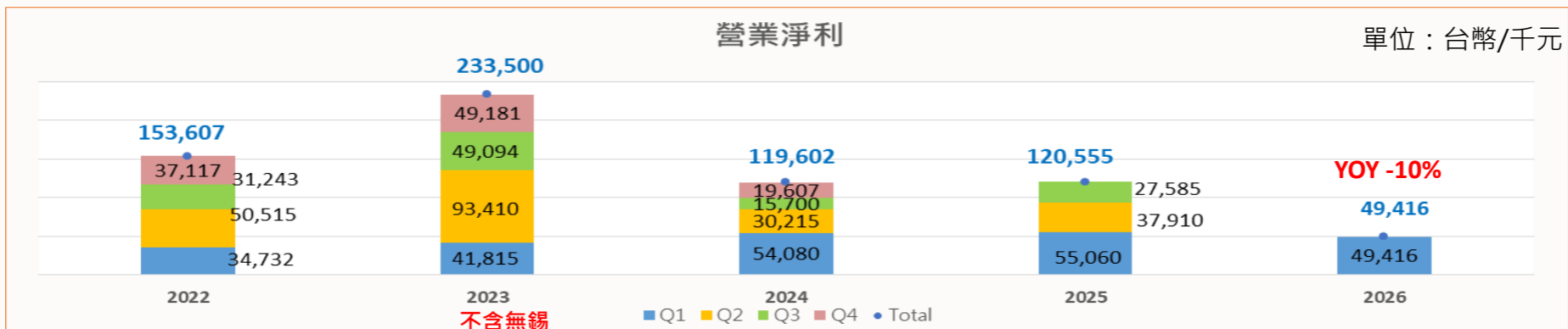
//

營運概況- 近五年獲利能力表現

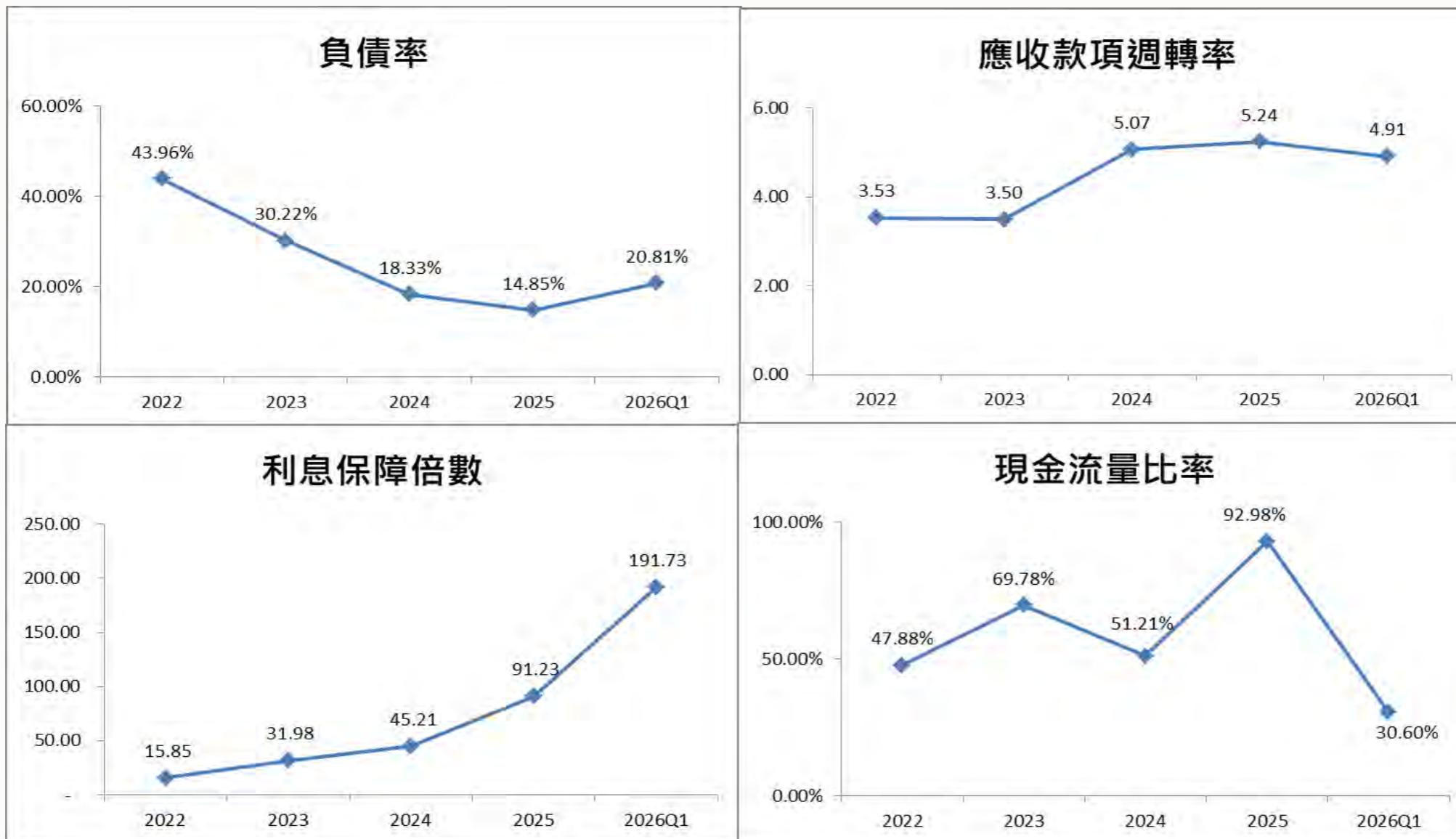


(註)：因大陸無錫子公司於2023年7月完成處分，故2023年度起各季合併損益業已依IFRS#5，將無錫子公司損益調整至停業單位，2023年度損益已不含無錫子公司。

營運概況- 近五年獲利能力表現



營運概況- 近五年財務表現





//

03

競爭利基

//

競爭利基- 一條龍完整製程技術、客製化滿足訂單需求



沖壓/
模具設計

旋壓成型

精密加工

齒型加工

熱處理

焊接

組裝

測試

40年汽車零件沖壓成型技術與相關模具設計及自製能力，能有效縮短沖壓產品的開發時程，並確保產品品質的穩定性

競爭利基- 高產品品質認證、跨足多元產業市場布局

高度技術整合能力(沖壓、精密機械加工、齒形加工、雷射銲接、熱處理、組裝測試等)，可生產汽車各類高精密度金屬零件部品，並可跨足多元化產業市場經營(例：半導體.....)



IATF 16949:2016



ISO 9001:2015

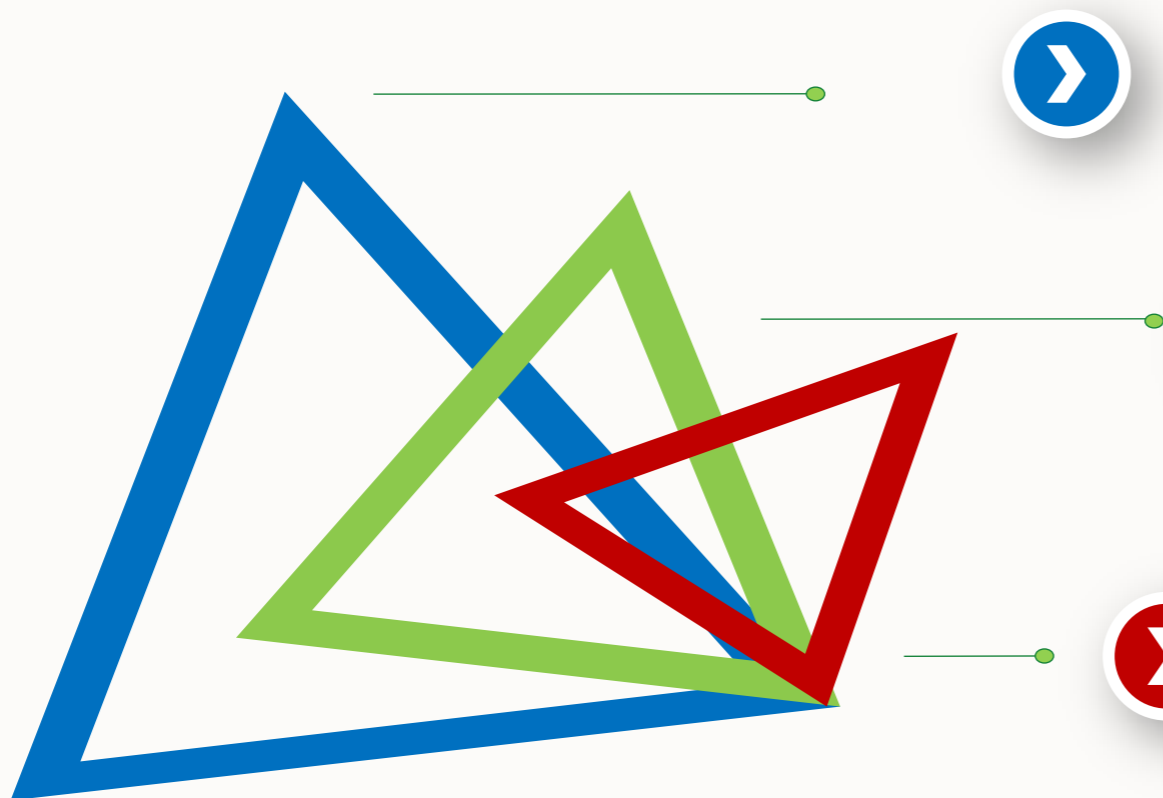


ISO 14001:2015



ISO 45001:2018

競爭利基-產品品質管理與認證



多元產業市場產品

- 累積AM市場多年經驗，掌握市場需求狀況，具備豐富的逆向開發及設計能力，並擁有完整之產品線，可滿足客戶One-stop shopping的需求
- 為汽車大廠Tier1、Tier2主要供應商，完善的OEM的品質管理能力，深得客戶信賴
- 已成功跨入新能源車、國際半導體設備之銷售領域，在產品轉型的路徑上，持續提升競爭力。

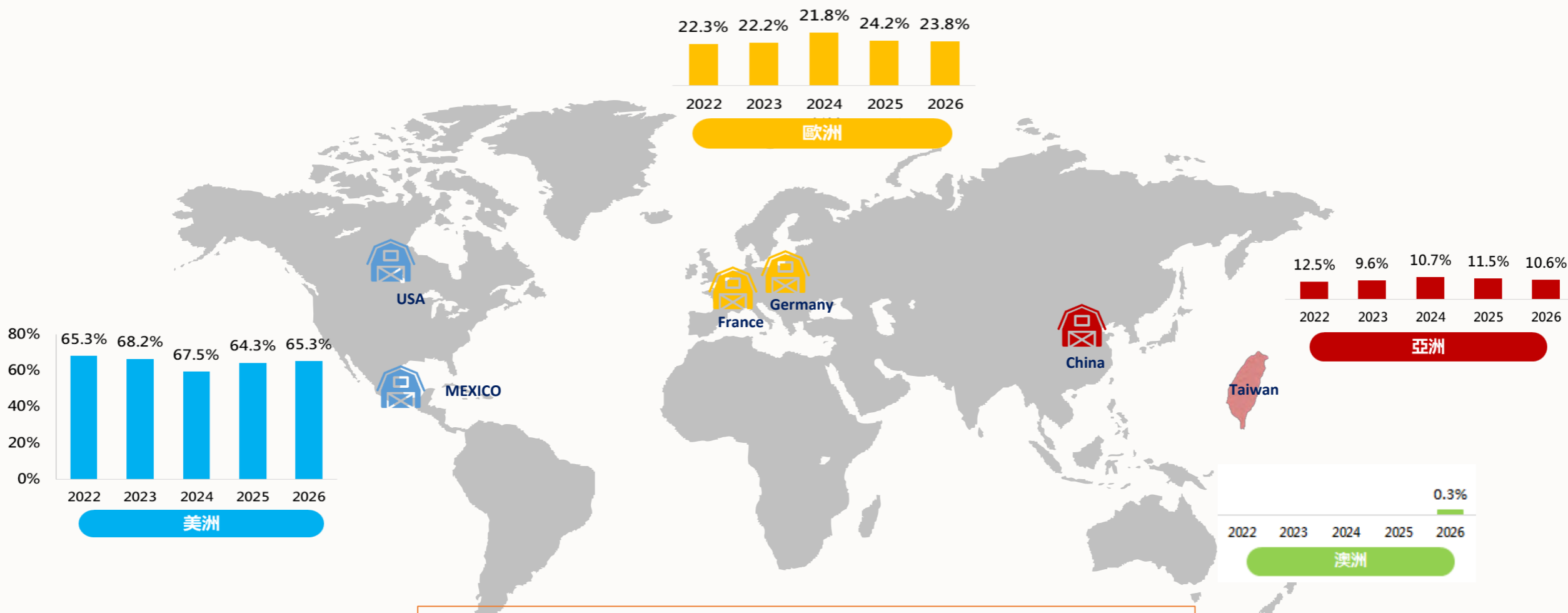
產品認證

- 產品市場認證時間約2~3年、生產工序繁複，產業進入障礙高，凸顯訂單能見度高
- 汽車業品質系統、航太品質系統驗證，以及國際半導體設備大廠之合格供應商認可

品質管理

- 自產品的原料採購至成品出貨階段，皆實施嚴格的品質管控，以確保每個環節完美順暢。
- 嚴格遵守品質政策，並持續的在進料、半成品和成品等各階段進行品質管制，確保所有的工序滿足客戶要求的最高標準及維持品質的穩定
- 實施 IATF 16949品質管理系統及ISO 14001環境管理系統等，更導入專業車廠之OEM生產線管理及TPM,5S,看板管理等生產制度，持續朝向“精實生產”而努力。

競爭利基-MIT生產、全球即時在地供應



台灣4個生產基地、全球5個海外倉據點
一地生產、全球供貨



//

04

未來發展

//

市場趨勢-半導體產業於東南亞的發展潛力、挑戰與展望

\$1,351億

2025年全球設備銷售(YOY+15%)
2027年將達\$1,560億美元

\$1,910億

2030年東協市場規模
CAGR 7.12%,來自EV、AI與5G需求

18座

2025年新晶圓廠
多數將於2026-2027年投產

發展潛力

供應鏈重組下的關鍵節點,China+1趨勢
推動製造移轉

設備市場

Local-for-local策略加速,零組件與模組化
需求上升

主要挑戰

高階人才缺口、基礎設施與法規
深度不足

封測與組裝基地

傳統角色定位

1

先進封裝中心

越南封測產能2030年達8-9%

3

未來趨勢

4

設備零組件製造
精密加工與維修服務

區域製造樞紐
高附加價值製造與研發

馬來西亞
封測與設備零組件製造重鎮

新加坡
先進製造、設備研發與區域營運中心

越南
新興封測與電子製造基地

東南亞正由傳統封測基地升級為「區域製造+設備服務+先進封裝」的複合型節點

市場趨勢-半導體設備市場概況

Market Size, 2025

\$118.9B

Market Estimate, 2026

\$126.1B

Market Forecast, 2033

\$224.9B

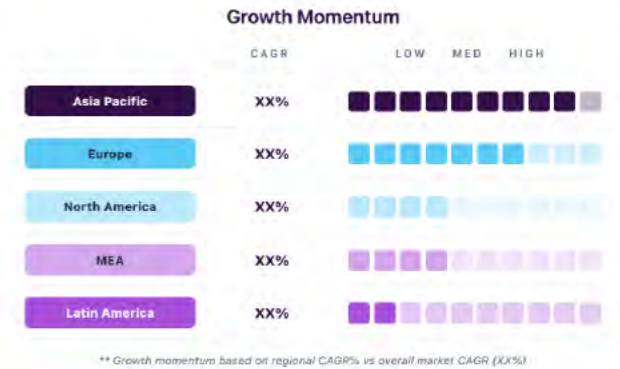
CAGR, 2026 - 2033

8.4%

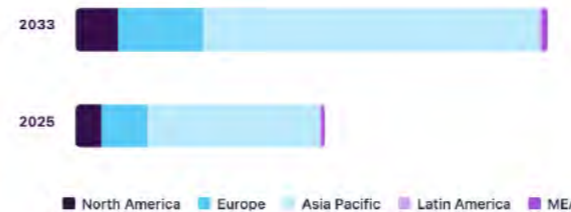
半導體製造設備市場概況

2025年全球半導體製造設備市場規模為1,189億美元，預計將從2026年的1,261億美元成長至2033年的2,249億美元，2026年至2033年的複合年增長率（CAGR）為8.4%。亞太地區市場佔主導地位，2025年營收份額達69.0%。電子產品在日常生活和專業領域的日益普及預計將在預測期內增加對半導體的需求，並推動半導體製造設備市場的成長。

Semiconductor Manufacturing Equipment Market Snapshot, 2021 - 2033



Global Semiconductor Manufacturing Equipment Market Size, By Region



Semiconductor Manufacturing Equipment Market, By Application, 2025



參考資料：<https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/semiconductor-manufacturing-equipment-market-report>

市場趨勢- 國際大廠於東南亞布局情形

全球變局下，東南亞國家建立半導體供應鍊態度積極。包含電動車、資料中心、伺服器等國際業者不斷湧入投資東南亞，將有機會能將供應鍊逐步延伸至半導體的上中下游



未來發展-積極拓展多元產業市場 進軍東南亞



馬來西亞廠YORU TECH

- 柔佛州新山區
- 投資金額USD880萬(倉佑持股55%)
- 目標市場：半導體設備關鍵零件

2025/10
廠房竣工

2026/1

取得使用執照
(CCC)

2026/6-7月
ISO 9001驗證

2026/Q4
量產啟動

2026/1-2月
設備搬遷

2026/2
取得營業執照(BL)

2026/Q3
客戶認證

2026/12
正式出貨

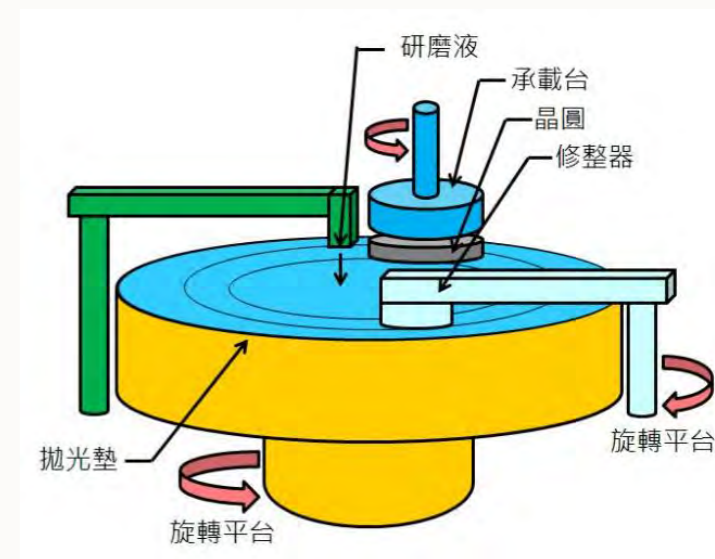
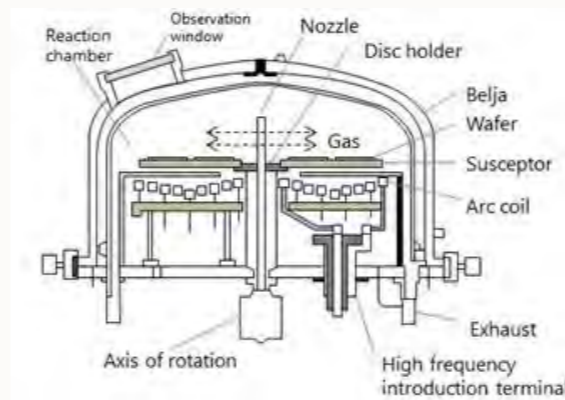


未來發展-半導體業務成為倉佑下一個成長動能

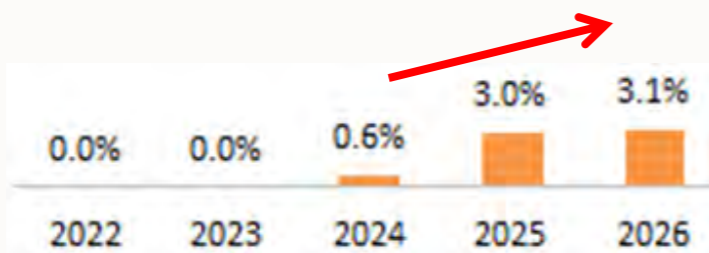
半導體設備類

倉佑供應之產品

半導體先進製程前段沉積及拋光設備零件等



CMP製程示意圖

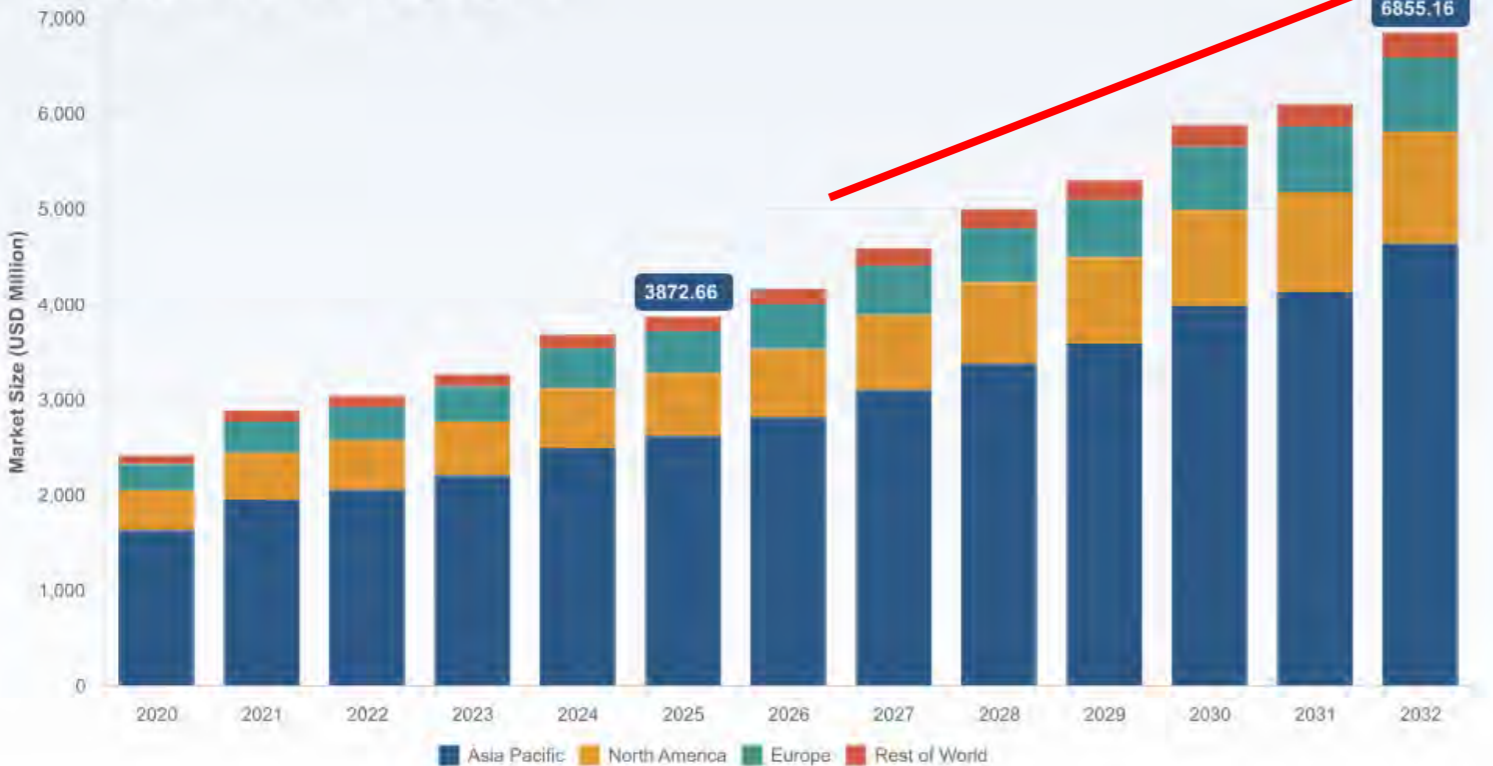


2026Q1半導體設備關鍵零件營收
YOY +48%

市場趨勢-CMP設備市場概況及成長預測

2025年CMP設備市場規模為38.7億美元，預計2032年將成長至68.6億美元，複合年增長率為8.5%。

CMP Equipment Market Size by Region



Source: www.pmarketresearch.com

2025 Market Segmentation & Regional Breakdown:

By Equipment Type: The 300mm CMP Equipment segment accounted for 79.7% market share in 2025.

By Application: The Foundry and Logic IC segment captured 59.9% market share in 2025.

Asia Pacific: USD 2.62 billion

North America: USD 663.7 million

Europe: USD 435.1 million

Rest of World: USD 151.8 million

未來發展-強化韌性、跨域未來

產品轉型

精進技術優勢，推動產品轉型，搶進產業新領域及多元產品市場，提升營收量能

生產專業化

深耕核心技術確保競爭優勢、持續精實生產，確保品質/成本/交期最佳化及風險的控管，提升營運韌性

數位轉型

推動數位轉型，朝向生產智能化、管理數位化，驅動企業新價值，提升產業競爭力



生產經營國際化

加速區域經濟佈局，建立短鏈供應能力，提升全球競爭力。

利基市場布局

分散外銷市場，降低貿易風險，在兼顧最大客戶北美市場外，也將積極開發歐洲及東南亞市場。

落實ESG永續發展

落實公司治理、環境共生、社會共榮，追求企業永續成長。

未來發展- 落實ESG永續



- ISO14001認證
- 已完成 ISO 14064-1 溫室氣體盤查、查證
- 太陽能佈建發電
- 建立環控看板，監控能源績效



- 2016年成立倉佑社會福利慈善事業基金會扶助弱勢
- 2023組建企業志工參與社福團體慈善活動
- 每年舉辦公益捐血活動、公益園遊會參與
- 持續資助弱勢團體、認購產品



- ISO45001認證
- 2022全國績優健康職場-健康管理獎
- 2021&2023全國績優健康職場-活力躍動獎
- 2024全國績優健康職場-健康周全獎
- 2024 嘉義縣職場參與戒菸服務成功獎 第一名
- 聘雇聽障人士，超額晉用弱勢勞工
- 制訂員工協助方案，讓員工工作安心 生活開心 健康放心



未來發展-公司治理評鑑表現優異

第12屆(2025) 公司治理評鑑

- 全體上市公司**前6%至20%**
- 市值未達50 億上市櫃公司**前2%至10%**



第11屆(2024) 公司治理評鑑

- 全體上市公司**前36%至50%**
- 市值未達50 億上市櫃公司**前2%至10%**

獲勞動部職安署114年度「企業永續報告書揭露職安績效評比」
TOP 10%績優企業



未來發展-重視股東權益，將實質營運成果回饋給股東共享

單位：新台幣 元/百分比

➤ 平均現金配息率68%



THANK YOU

Q & A



TSANGYOW

倉佑致力於了解每個客戶，以期提供符合甚至超越客戶要求的服務。使彼此成為通往成功道路上的最佳伙伴，以達到雙贏的局面。

 : <https://www.tsangyow.com.tw/tw/index.php>